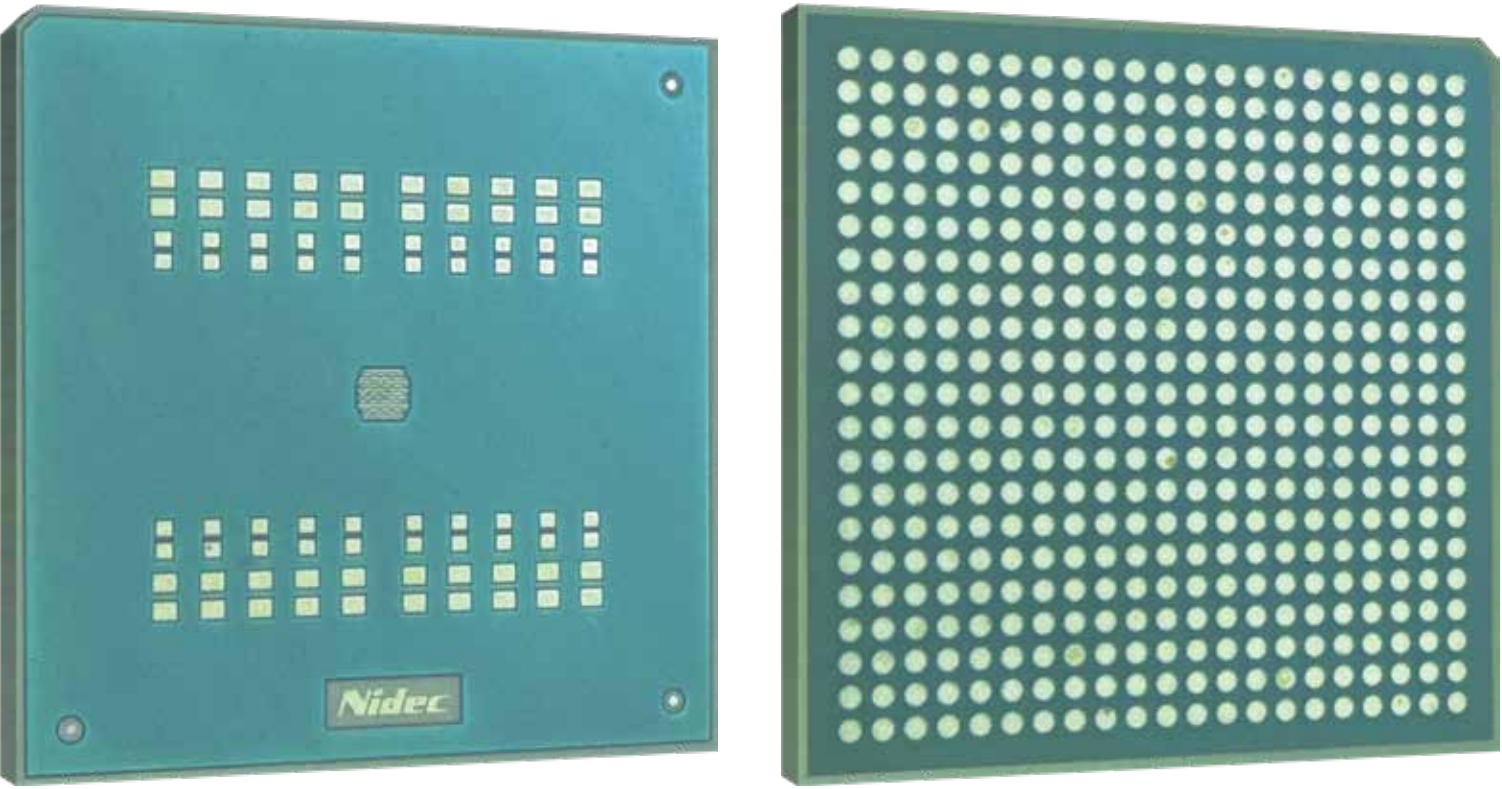
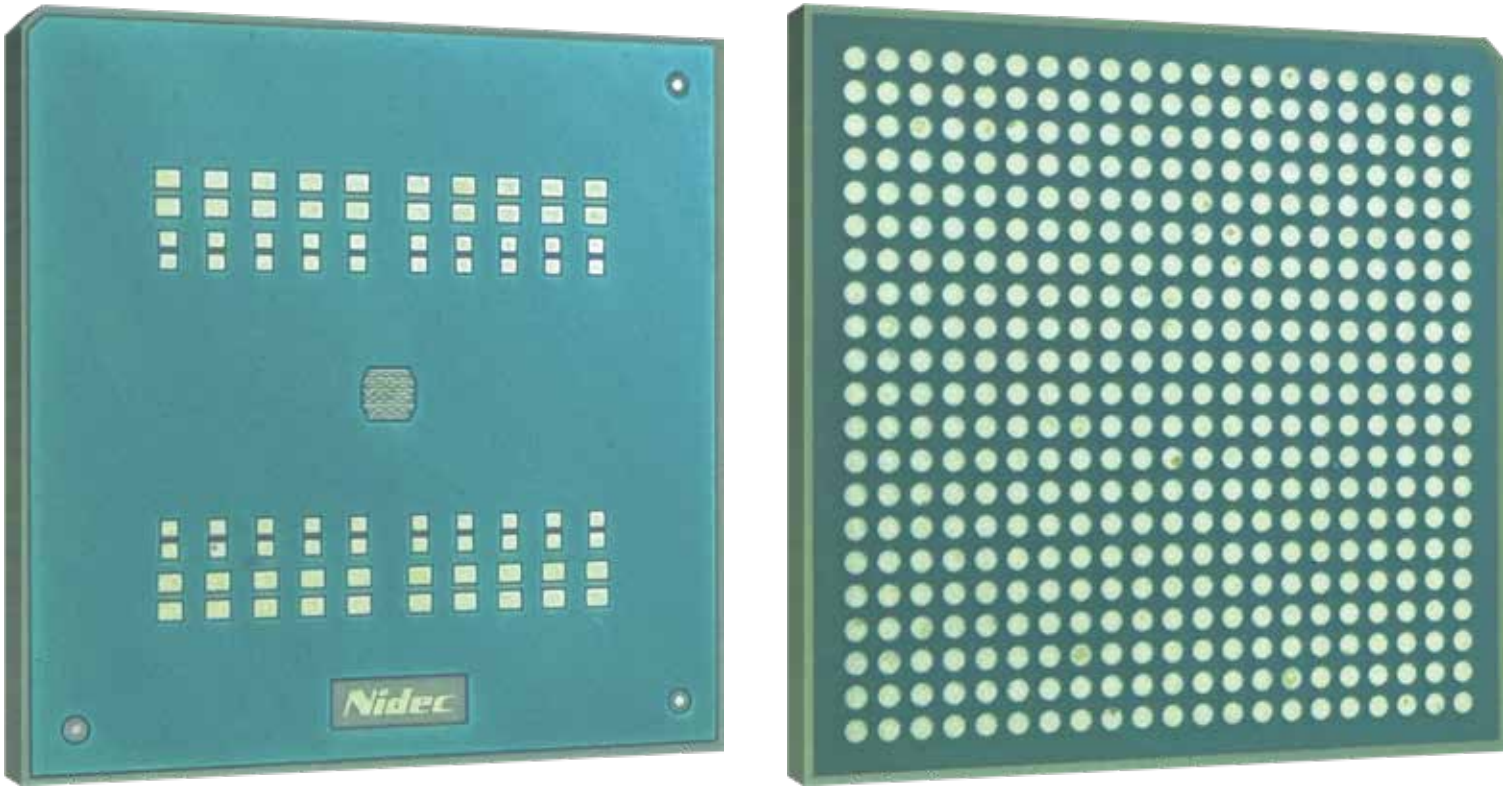


Image		
O.D.	23mmSQ	23mmSQ
Structure	2/2/2	2/2/2
Thickness	1mm	250um
Pad Pitch	120um	120um
Pad DIA.	70um	70um
L/S	17/20um	17/20um

Characteristics

SAP工法による MLO基板の少量、試作レベルの数量でカスタム品製作が可能。
薄物対応として全層SAP工法による製作が可能。厚物から薄物までぜひ製品開発の一助にお役立てください。

Custom MLO substrates can be produced in small quantities at the prototype level using the SAP process.
Thin substrates can be manufactured using the full-layer SAP process.
Please utilize our products—from thick to thin—to assist in your product development.

- カスタム設計歓迎

■ 薄コア基板使用可能 (~40um)

■ 挟ピッチ、小径ビア
- Custom design welcome

■ Thin core material (~40um)

■ Small Pitch and Small Via Diameter

SAP Design Rule

	～2025	2026/1H～
Via DIA.	25um	25um
Min. Via Land DIA.	50um	50um
Min. L/S	20/25um	15/15um
Min. Probe Pad Pitch	75um	65um
Min. Probe Pad DIA.	55um	50um